



SIIP CHINA
SEMI产业创新投资平台

半导体产业新闻半月刊（精华版）

2019/0603-2019/0615



专题分类



并购投资

- 点评：
- ① SiFive完成6540万新融资，高通领投英特尔三星跟投。
 - ② 紫光国微拟收购安全芯片组件生产商Linxens。
 - ③ 英飞凌将以100亿美元收购赛普拉斯。
 - ④ 华为收购俄罗斯安防技术公司Vokord。



领域	时间	事件	原因/内容	资金(美元)
RISC-V	2019/06/10	SiFive完成了新一轮融资	战略融资 。除高通外，英特尔和三星这两大巨头也为该公司投入一些资金。	0.65亿
网络芯片	2019/06/11	英特尔收购网络芯片公司Barefoot	战略收购 。在加强Barefoot网络芯片技术的同时更好地与博通公司竞争。	
智能安全芯片	2019/06/03	紫光国微拟收购Linxens	强强联手 。Linxens与紫光国微的安全芯片业务，属产业链上下游，具有很强的协同效应。	26亿
微控制器等	2019/06/03	英飞凌将收购赛普拉斯	优势互补 。并购赛普拉斯之后，英飞凌将会强化推动结构增长的核心，并将公司的技术应用至更广泛的领域。	100亿
IC制造	2019/06/04	台积电出售中芯国际股权	资本回报 。台积电的目的是处分透过其他综合损益按公允价值衡量之金融资产。	0.04亿
激光雷达	2019/06/13	Innoviz完成C轮融资	战略融资 。新的资金将支持Innoviz的几项关键举措，包括其增强的感知软件开发。	1.7亿
3D视觉	2019/06/05	光鉴科技获A轮融资	战略融资 。资金将主要用于光鉴3D视觉产品的量产，并继续保持对于核心技术研发团队和市场团队的扩充，加速3D视觉在智能终端、新零售、智慧社区等生态的布局。	0.15亿
安防技术	2019/06/04	华为收购俄罗斯安防技术公司	技术储备 。主要目的是该公司在人脸识别系统方面的技术专利与研发人才。	0.5亿



本土产业

- 点评：
- ①山西省半导体产业联盟在长治成立。
 - ②创新工场完成25亿元募资，成立大湾区新总部
 - ③江西、湖南、安徽、晋江、苏州、广州等地近期引进半导体项目。



【山西省半导体产业联盟成立】

5月29日，山西省半导体产业联盟在长治成立。未来，这一组织将通过对半导体产业的技术研究与自主创新，形成具有自主知识产权的产业标准和专有技术，对制约行业发展的重大难题和关键技术进行联合攻关，共同提升山西省半导体产业的创新水平和产品竞争力。

【江丰电子西安靶材项目开工】

6月2日，西安高新区海创园半导体材料项目在高新区长安通讯产业园正式开工。宁波江丰电子材料股份有限公司与绿城中国计划在西安高新区投资建设“海创园半导体材料项目”，预计投资2亿元，建设超高纯金属溅射靶材研发和生产基地。

【创新工场完成25亿募资，成立大湾区总部】

近日，创新工场大湾区总部在广州黄埔区启动。现场，创新工场总裁陶宁表示，创新工场第三期人民币基金已经募集完成，基金规模25亿，落户在广州，主要投资方向是人工智能、大数据、教育、消费升级、B2B 企业服务等。截至目前，创新工场管理的双币基金规模约150亿元人民币。



【200亿元晶圆厂项目落地江西赣州】

6月6日，江西赣州经开区与名芯有限公司（香港）、电子科技大学广东电子信息工程研究院签订三方合作框架协议，总投资200亿元的名芯半导体项目落户赣州经开区。项目分为二期建设，一期投资60亿元，建设一条8英寸功率晶圆生产线；二期投资120-140亿元，规划建设第三代6/8英寸晶圆制造生产线或12英寸硅基晶圆制造生产线。

【湖南拟建设先进晶圆生产线】

6月12日，湖南南方海绵发展有限公司与中国电子系统技术有限公司进行了签约。中电常德芯片产业园项目将由中国电子信息产业集团联合湖南南方海绵城市发展有限公司等共同建设，总投资约300亿元，拟建设先进的晶圆生产线。

【CISSOID和中科院电工所联合推动碳化硅功率器件广泛应用】

近日，CISSOID宣布已与中国科学院电工研究所达成战略合作关系，将共同开展基于碳化硅功率模块的系统研发项目，攻克技术难题，实现耐高温、耐高压、高能量密度、高效率等优势，推动碳化硅功率器件在新能源汽车领域实现广泛应用。



【东旭锦州光电产业园项目开工】

6月6日，东旭（锦州）光电产业园项目正式开工。光电产业园总投资约165.5亿元，占地面积约1500亩。产业园由5个单体项目组成，分别是载板玻璃项目、车载显示盖板项目、光学膜项目、调光玻璃项目和机器人制造项目。

【凯盛科技安徽再建超大屏触控模组项目】

近日，凯盛科技股份有限公司发布公告，公司全资子公司凯盛信息显示材料（池州）有限公司，拟投资8762万元在安徽省池州经济技术开发区内建设超大屏触控模组项目。

【导光膜全链条生产线项目签约落地晋江】

6月11日，晋江（粤港澳）投资推介会暨招商项目集中签约仪式在深圳举行。现场共签下10个项目，总投资额65.2亿元。其中，本次签约了导光膜全链条生产线，该项目将在晋江建设导光膜产品一条龙的全链条生产项目，未来产品将广泛运用于5G手机、柔性屏手机。

【康佳布局半导体业务再有新动作】

6月13日，康佳集团发布公告称，为了加快公司半导体业务发展，与重庆市璧山区人民政府签署了《合作框架协议》和《工业项目投资合同》，拟在重庆市璧山区建设重庆康佳半导体光电产业园，并引入光电行业的相关项目。



【PZT压电薄膜MEMS器件联合实验室落户苏州】

5月30日，由苏州纳米科技发展有限公司与日本爱发科（ULVAC）共建的PZT压电薄膜MEMS器件联合实验室落户苏州纳米城，双方将共同推动PZT压电薄膜材料在MEMS器件制造领域的应用。

【江西九江仁创艺电子项目开工】

5月31日，江西省九江经济技术开发区2019年度第一批重大项目集中签约、集中开工仪式在城西港区举行。此次集中签约和开工的44个重大项目，投资总额达182亿元，涵盖了现代装备制造、电子信息、新能源、新材料、新业态等多个领域。

【比亚迪锂电池项目落户广州增城】

6月2日，比亚迪锂电池增城生产基地项目投资协议签约仪式在广州增城区举行。比亚迪锂电池增城生产基地项目由比亚迪公司投资，主要从事聚合物锂离子电池的研发、生产和制造，产品将应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、电动工具等电子设备。项目固定资产总投资40亿元，预计达产可实现年产值130亿元。

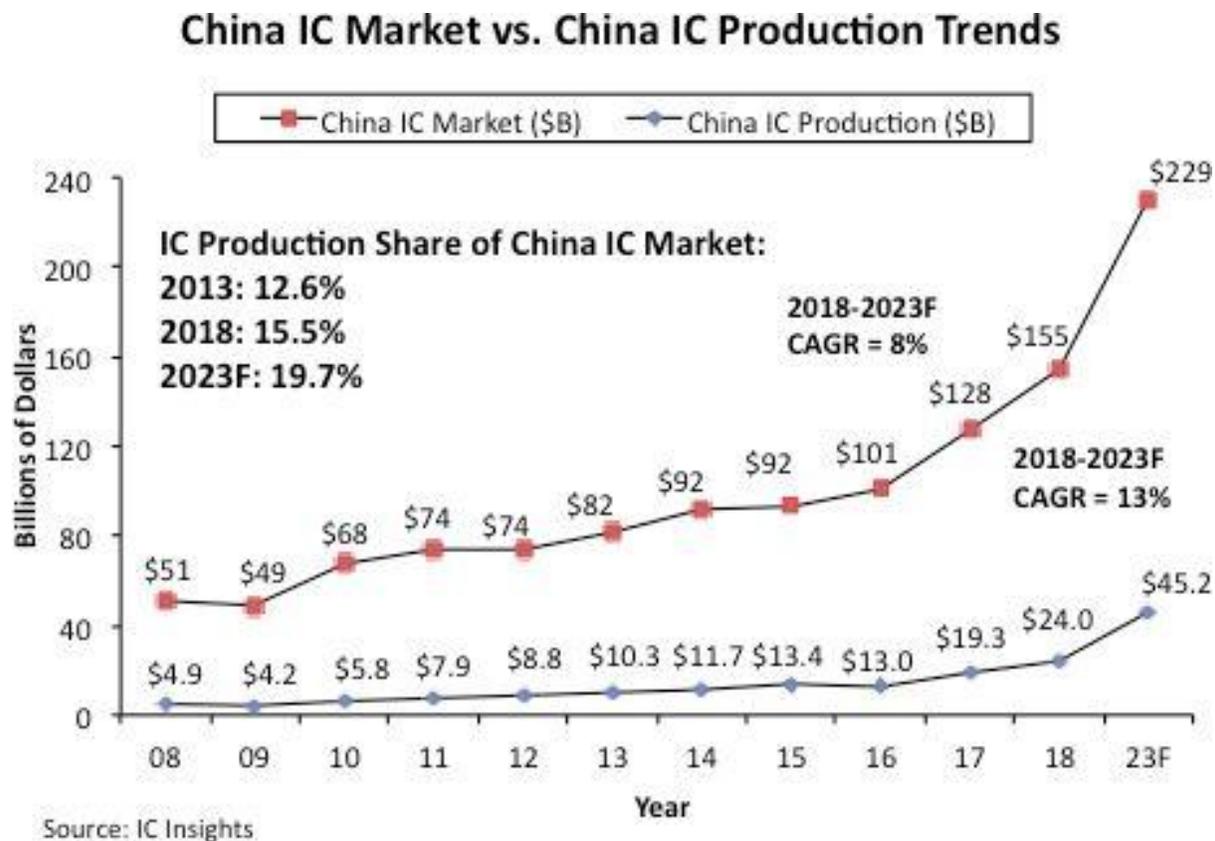


市场数据

- 点评：
- ① IC Insights预测2023年中国IC将占全球市场的8.4%，五到十年内仍难以自给自足。
 - ② 通信IC市场份额再次超越计算机IC，成为最大的集成电路终端市场。
 - ③ Q2全球晶圆代工厂排名：台积电第一，中芯第五。
 - ④ 下滑从14%扩大到19%，SEMI下调今年全球晶圆厂设备支出预估。



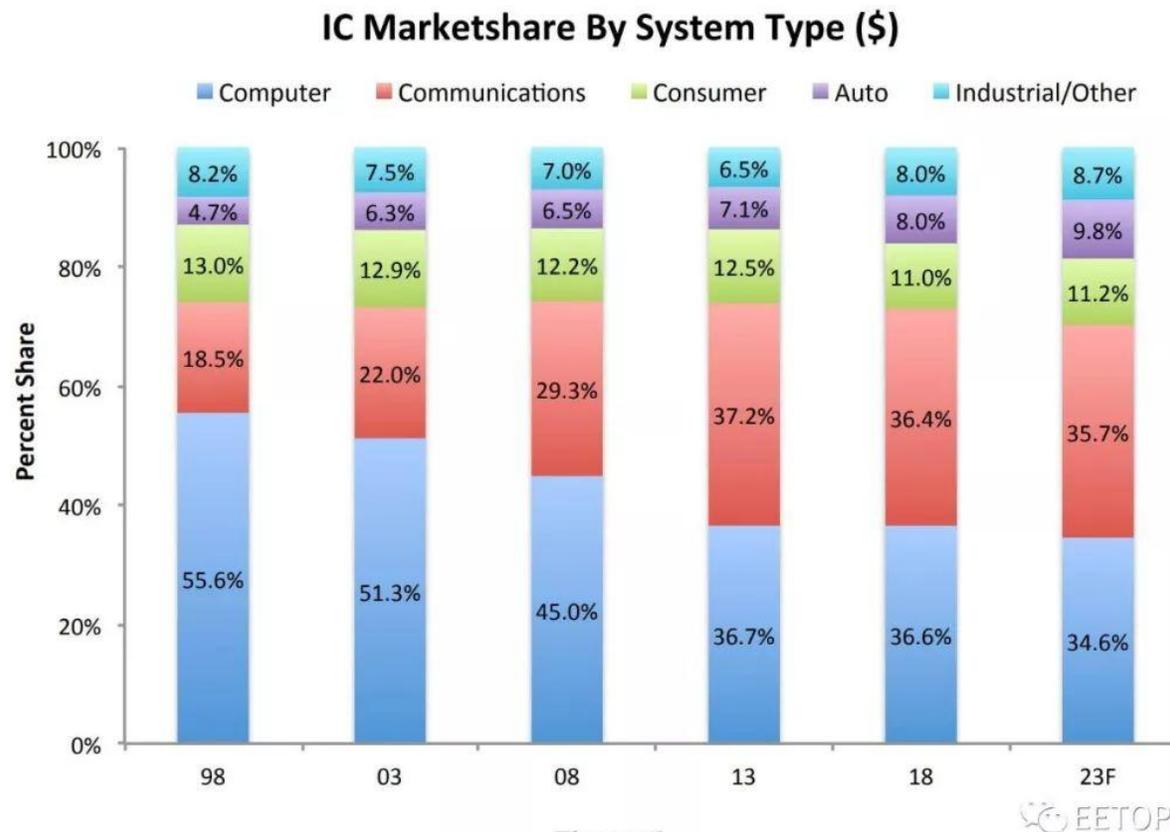
【IC Insights: 2023年中国IC将占全球IC市场总额的8.4%】



IC Insights估计，中国的IC制造业能在2023年增长到至452亿美元，但仍将仅占2023年全球IC市场预测总额5388亿美元的8.4%。此外，IC Insights认为中国很难在未来五到十年内实现IC需求的自给自足。



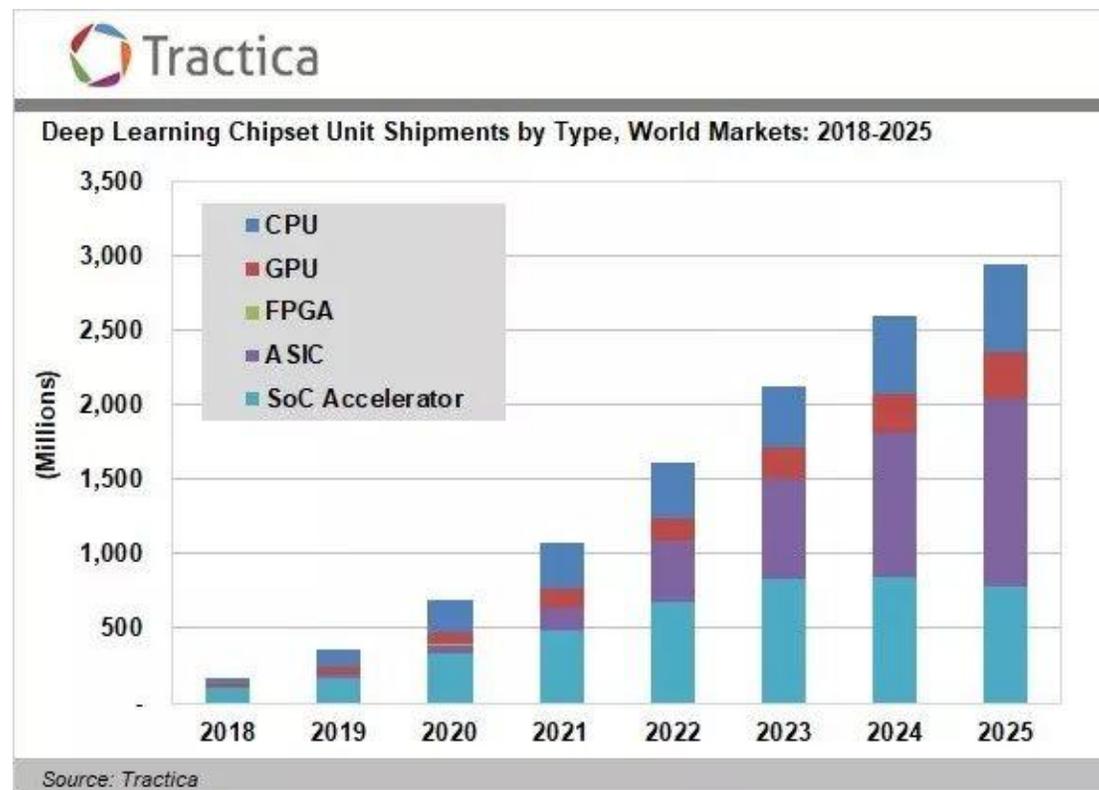
【通信IC市场份额成为最大的集成电路终端市场】



IC Insights发布的最新报告显示，通信IC市场份额再次超越计算机IC市场。在过去的20年中，通信IC市场所占份额几乎翻了一番，从1998年的18.5%增加到2018年的36.4%。



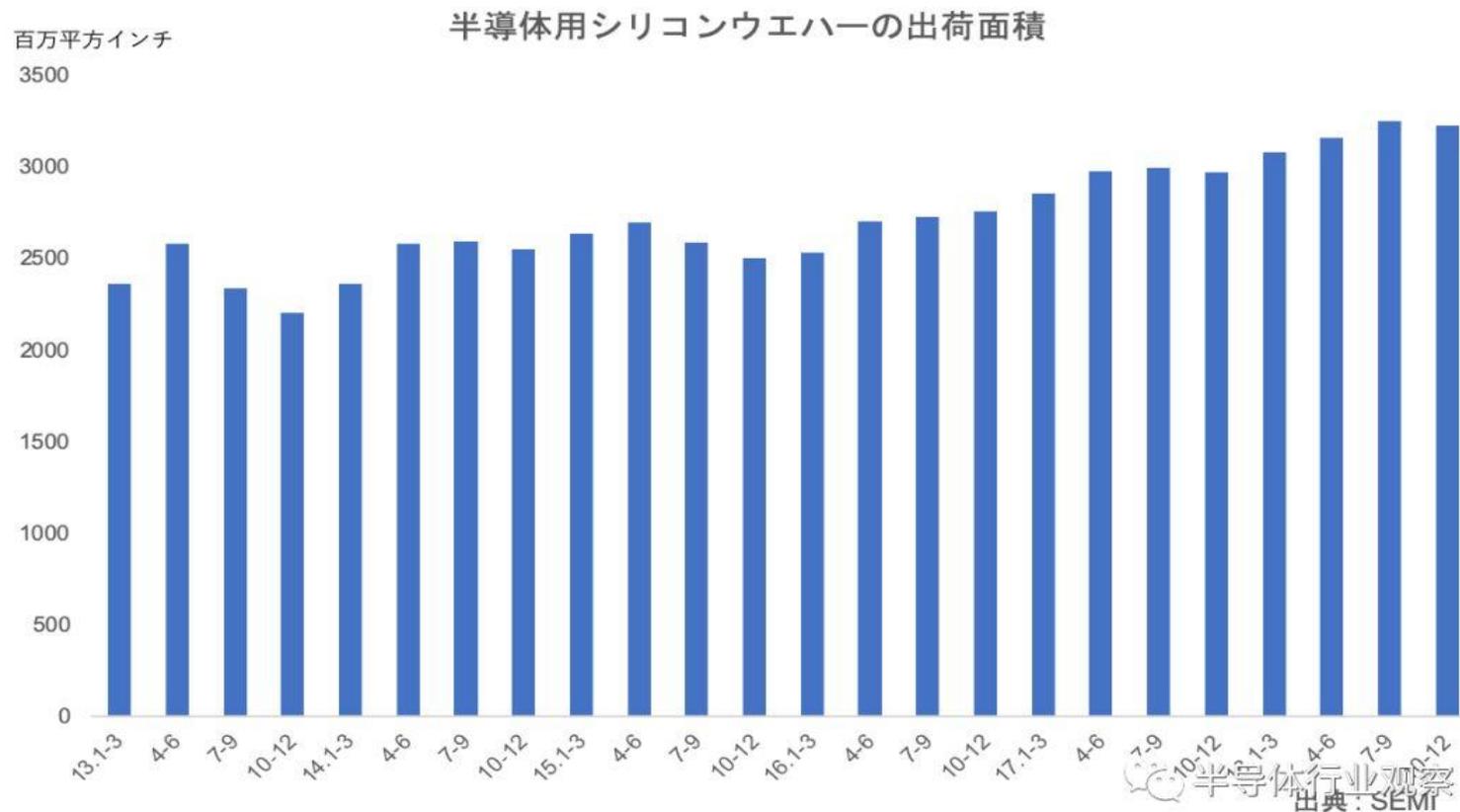
【预计2025年深度学习芯片销量达到29亿】



Tractica预测，AI市场的这种增长和演变将推动深度学习芯片组的出货量从2018年的1.649亿增长到2025年的29亿单位以上。



【硅晶圆市场疲软 2019年预计会出现8%的供给过剩】



SEMI 公布了2019年1月-3月的硅晶圆的出货面积，与2018年Q4相比减少了0.7%，下滑至32.33亿平方英寸，这是时隔一年首次出现负增长。



【Q2全球晶圆代工厂排名：台积电第一，中芯第五】

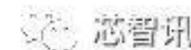
表、2019年第二季度全球前10大晶圆代工营收排名 (单位:百万美元)

Ranking	Company	2Q-19E	2Q-18	YoY	M/S
1	台积电	7,553	7,850	-4%	49.2%
2	三星	2,773	3,062	-9%	18.0%
3	格芯	1,336	1,521	-12%	8.7%
4	联电	1,160	1,332	-13%	7.5%
5	中芯	790	891	-11%	5.1%
6	高塔半导体	306	335	-9%	2.0%
7	华虹半导体	230	230	0%	1.5%
8	世界先进	214	231	-8%	1.4%
9	力晶	194	335	-42%	1.3%
10	东部高科	144	153	-6%	0.9%
Others		665	808	-18%	4.4%
Total		15,363	16,748	-8%	100.0%

注：

1. 三星计入System LSI及晶圆代工事业部之营收
2. 格芯计入IBM业务收入
3. 力晶仅计入晶圆代工营收

数据来源：拓璞产业研究院，2019年6月



近日，集邦科技旗下的拓璞产业研究院日前发布了2019年Q2季度全球TOP10晶圆代工厂榜单，受整体市场下滑的影响，Q2季度10大厂商的营收几乎都在下滑，当季总营收只有153.6亿美元，同比下滑了8%。



【SEMI 下调今年全球晶圆厂设备支出预估】

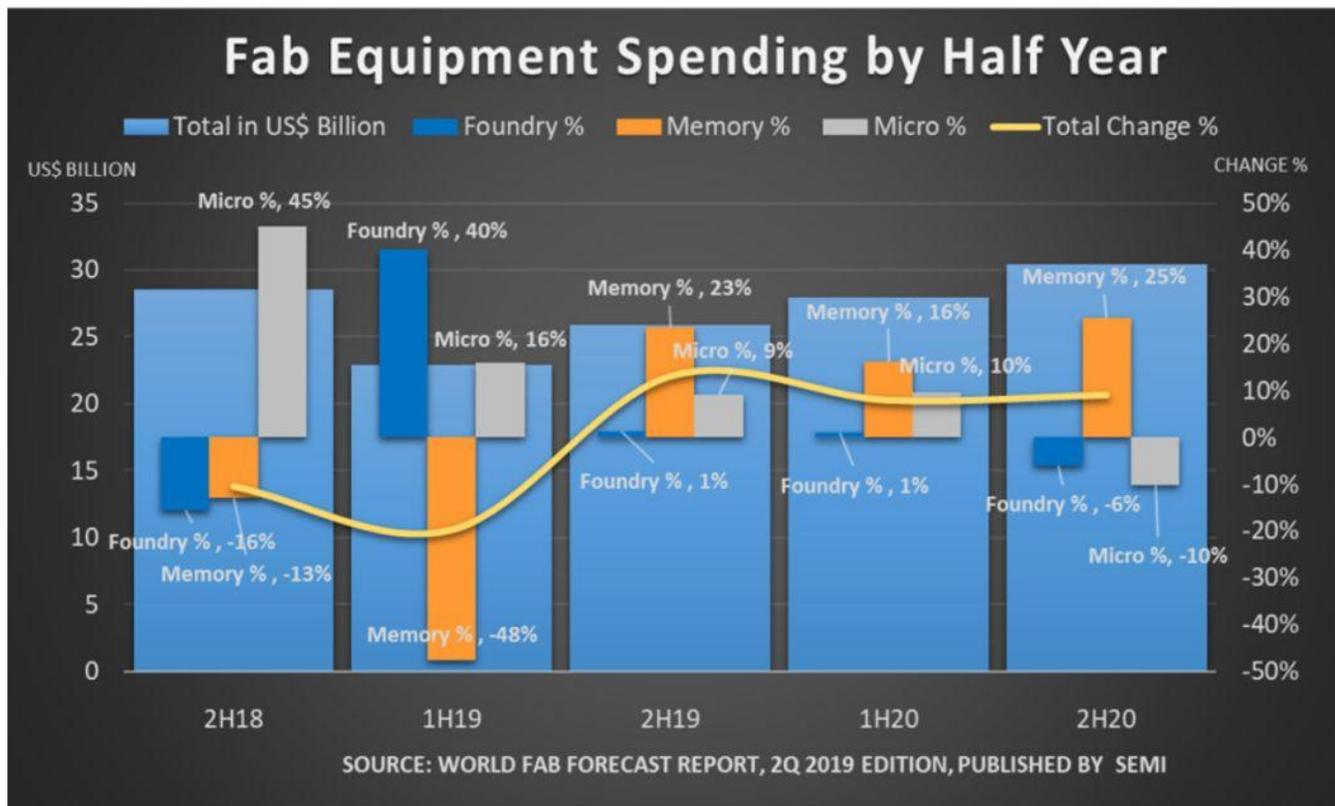


Figure 1: Fab equipment spending by half year from 2018 to 2020

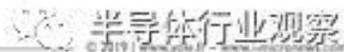
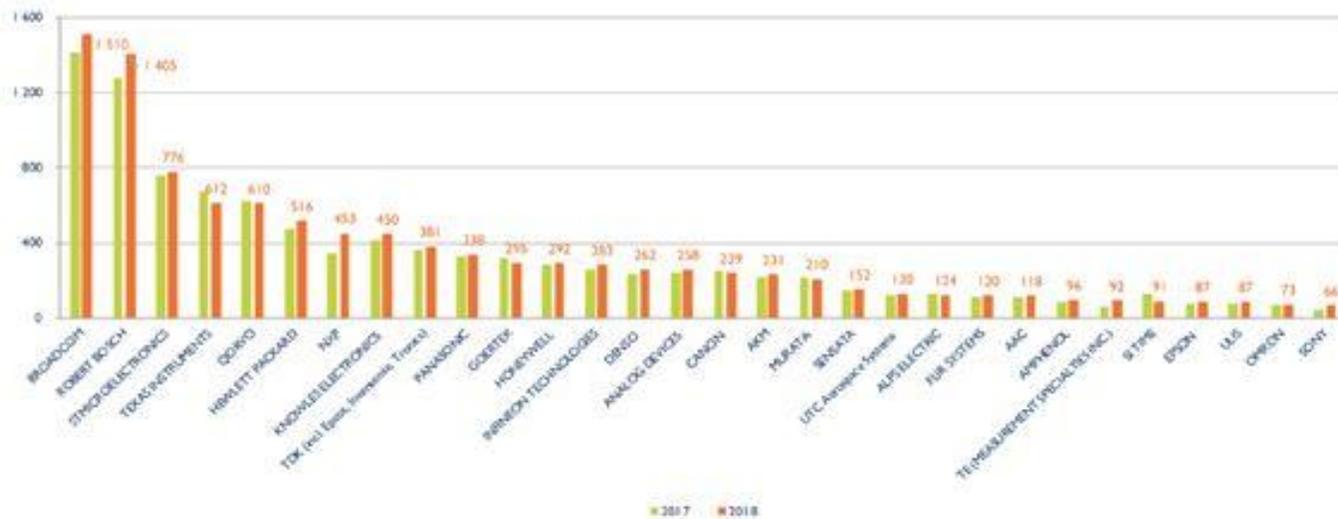
SEMI 更新2019年第二季全球晶圆厂预测报告，下调了今年全球晶圆厂设备支出预估，今年预估由原先下滑14%，进一步扩大为下滑19%至484亿美元，明年成长率则由原先27%下调至20%，达到584亿美元，虽有反弹，但仍较2018年的投资金额减少20亿美元。



【2018年MEMS企业TOP30的总销售额同比增加了5%】

2018 Top MEMS manufacturers – In US\$ million

(Source: Status of the MEMS Industry report, Yole Développement, 2019)

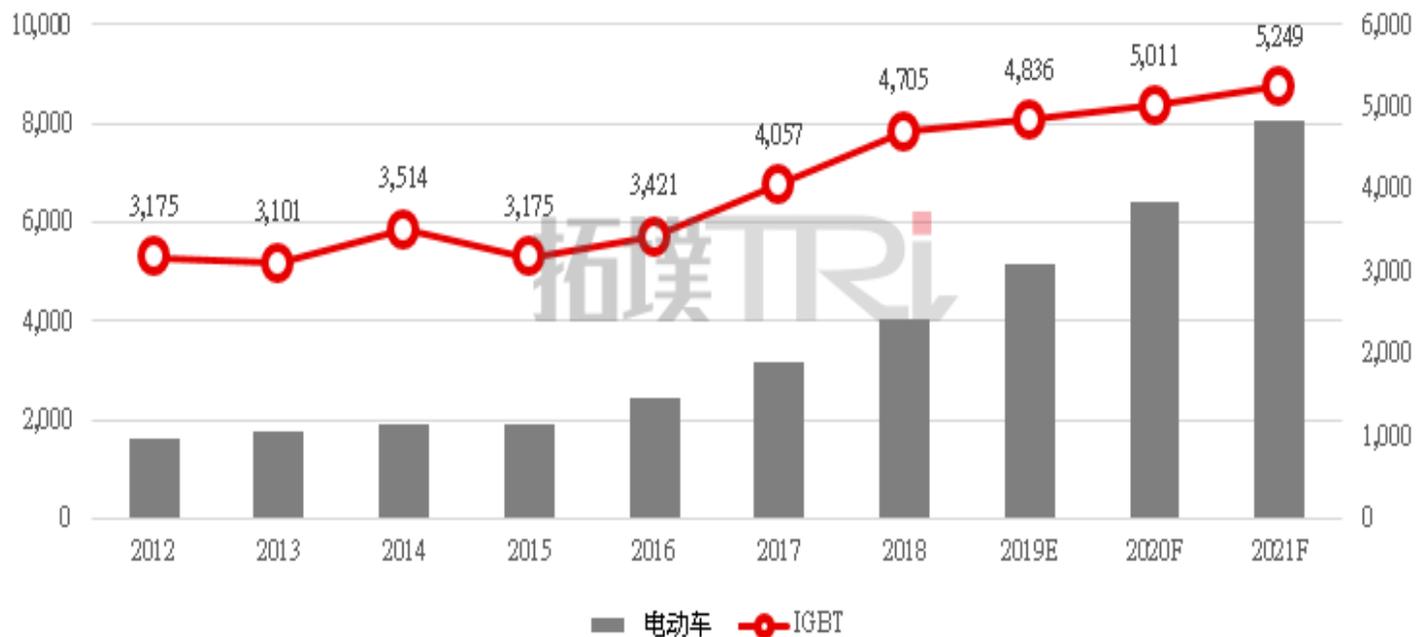


Yole预测，2018年MEMS企业TOP30的总销售额比2017年增加了5%，增至103亿美元（约人民币700.4亿元）。



【IGBT产值2021年突破52亿美元】

图、IGBT总值对电动车销售数量预估



数据来源：拓璞产业研究院，2019年6月

根据集邦咨询的统计，2016年至2018年，电动汽车数量年成长率分别为28%、29%、27%（2015年以前的年成长率仅个位数），同时也推升IGBT总值大幅成长，2018年全球IGBT市场总市值规模约47亿美元，年成长率达16%。



【京东方跃居全球面板龙头】

主要面板廠產能市佔			
面板廠	2019年市佔率	面板廠	2023年市佔率
京東方	18%	京東方	21%
LGD	17%	華星光電	16%
群創	14%	LGD	12%
三星	12%	群創	9%
友達	11%	友達	8%
其他	28%	其他	34%

資料來源：IHS Markit 製表：袁顯庭

根据IHS Markit统计，今年京东方出货面积市占率将达到18%、首度超越LGD（17%），跃升为全球面板龙头。



产业合作

- 点评：
- ①隆基股份携手通威股份，联合发力单晶项目。
 - ②三星与AMD在芯片领域合作，获得定制图形IP授权。
 - ③中国邮政牵手华为战略合作，寄递科技与金融优势互补-物联云仓。
 - ④韩国携手芬兰 率先进行6G网络开发合作。



领域	合作公司/单位	目的
硅材料	隆基股份、通威股份	双方就高纯晶硅、硅片合作事项达成合作意向。
图形处理器	AMD、三星	双方将在芯片领域开展更加深入的合作。AMD将其基于RDNA图形架构的定制图形IP授权给三星，并将集成在三星未来的移动SoC处理器中。后续，双方将以Radeon显示卡技术为基础，在超低功耗、高性能移动图形处理器IP上展开为期多年的合作，共同拓展移动通信市场。
视觉处理芯片	新思科技、Kudan	新思科技ARC EV6x视觉处理器IP和KudanSLAM软件相结合，为人工智能，汽车和物联网应用提供高效精确的机器视觉技术。
智能穿戴	华米、高通	双方在智能可穿戴产品领域达成合作。
智能物流	华为、邮政	双方基于各自核心竞争力，建立全面战略合作伙伴关系，在金融业务、科技创新、寄递物流、人才培养等方面开展深入合作，实现共同发展。
自动驾驶	NXP、Momenta	将合作开发车规级驾驶员监测解决方案（DMS），携手提升道路安全。
6G	韩国、芬兰	韩国电子通信研究院（ETRI）日前已经与芬兰奥卢大学签署了一份谅解备忘录，以开发第六代（6G）网络技术。



设计制造

- 点评：
- ①格芯与Soitec签署多项长期SOI晶圆供应协议。
 - ②三星与英飞凌谈合作，加速晶圆代工业务。
 - ③Synopsys推出PrimeYield，使芯片良率分析和优化速度加快100倍。
 - ④应用材料在台湾新建显示设备工厂。



【格芯与Soitec签署多项长期SOI晶圆供应协议】

格芯与Soitec于近日宣布，已签署了多项300mm绝缘硅（SOI）晶圆的长期供应协议。协议将确保SOI晶圆的大批量供应，以满足格芯客户针对射频绝缘体上硅（RF-SOI）、全耗尽绝缘体上硅（FD-SOI）和硅光子技术这些差异化平台不断增长的需求。

【三星与英飞凌谈合作，加速晶圆代工业务】

据theinvestor透露，为了加快全球非存储芯片产业发展，三星正在通过扩大与英飞凌的合作伙伴关系，增加其在全球晶圆代工领域的业务。

【IMT宣布提供8英寸晶圆MEMS加工服务】

Innovative Micro Technology（IMT）近日宣布：公司现已可提供8英寸MEMS工艺加工服务，同时公司还可以为MEMS行业发展提供空前丰富的其他资源组合。8英寸晶圆改变了MEMS器件制造的经济指标，每张晶圆可以产出大约为6英寸晶圆两倍数量的器件。

【Synopsys推出PrimeYield，使芯片良率分析和优化速度加快100倍】

Synopsys近日宣布推出其 PrimeYield™ 解决方案，这是获得专利的快速统计方法和先进的机器学习技术加速支持的投片前设计良率分析的一项突破。它提供比现有解决方案快1000多倍的设计良率分析和优化，可扩展到具有数十亿晶体管的量产系统级芯片（SoC），使 SoC 设计者能够将设计良率优化左移至投片前的设计阶段。



【Silicon Sensing Systems扩大MEMS代工产能】

日本Silicon Sensing Systems公司将扩大其在日本的MEMS代工厂规模，新增的厂房设施，主要为了满足MEMS惯性传感器和溅射PZT（锆钛酸铅）薄膜MEMS器件显著增长需求。新厂房占地面积3000平方米，直接将当前的晶圆产量提升一倍以上。

【海威华芯发布毫米波频段用砷化镓工艺】

近日，成都海威华芯科技有限公司（HiWafer）成功完成首套0.15微米砷化镓（GaAs）工艺制程开发。Hiwafer PPA15工艺基于先进的高电子迁移率晶体管（pHEMT）器件结构，具有工作频率高、输出功率密度大、噪声系数低等优点，工艺性能达到业界先进水平。

【华虹七厂首批光刻机搬入】

6月6日，华虹无锡集成电路研发和制造基地（华虹七厂）一期12英寸生产线建设项目首批光刻机搬入仪式顺利举行。

【应用材料在台湾新建显示设备工厂】

近日，应用材料公司在台南科学园（STSP）开设了第二座显示设备制造中心和研发实验室，旨在探索10.5代LCD面板等先进显示材料和设备，并抓住柔性和刚性OLED显示解决方案的商机。



产品应用

点评：①新能源汽车、传感器、显示器领域火热，各厂商纷纷推出新产品。



领域	公司/单位	产品及特性
功率器件	Qorvo	推出MMIC功率放大器，该放大器在 32-38GHz 频段提供超过10瓦饱和功率。
功率器件	英飞凌	推出CoolSiC™ MOSFET 1200V单管新产品。新产品导通电阻从30 mΩ到350 mΩ不等，拥有TO247-3pin和TO247-4pin两种封装。
Wi-Fi芯片	Dialog	推出FC9000，目标应用为智能门锁、视频监控系统、智能恒温器、无线传感器等电池供电的IoT设备。
传感器	捷杰传感	推出第四代设备监控与预测诊断智能MEMS传感器。
传感器	英飞凌	推出防水防尘压力传感器DPS368，可同时测量气压与温度。
传感器	豪威科技	发布其首款0.8微米，加载Purecel® Plus堆栈式技术的3200万像素图像传感器OV32A。
IOI芯片	索尼	推出一款芯片，它将可能改变电动自行车、汽车、路灯以及其他各种联网设备传递信息的方式。
激光雷达	Cepton Technologies	推出了其线扫描激光雷达传感器SORA系列的最新款产品SORA-P60，可提供精确的高速3D扫描，实现对象的自动分类和体积扫描。
显示器	苹果	推出名为Pro Display XDR的专业级6K显示器。Pro Display XDR搭载了一块32英寸LCD面板，分辨率为6016×3384，并支持P3广色域，10bit色深，超广可视角度，纳米纹理防眩光玻璃。
显示器	三星、LG	同步推出MicroLED商用显示器，并展示QLED、OLED新技术。



大国重器

- 点评：
- ①中俄将投资10亿美元成立联合科创基金。
 - ②清华、华为签署科技合作框架协议。
 - ③北大/清华/复旦/厦大获批国家集成电路产教融合创新平台。



【中俄将投资10亿美元成立联合科创基金】

6月5日俄罗斯直接投资基金发布消息称，该基金与中国投资有限责任公司商定将投资10亿美元成立俄中科技创新基金。相关文件由中国科技部和俄罗斯经济发展部共同签署。

【清华、华为签署科技合作框架协议】

- ① 6月3日，清华大学与华为公司签署科技合作框架协议，促进双方合作迈向新台阶。清华大学与华为公司校企合作座谈会同期举行。
- ② 清华大学校长邱勇表示，清华大学与华为公司的合作进入新的发展阶段，希望双方瞄准未来发展趋势，着眼于双方战略的交汇点，服务于更具长远意义的战略目标，创新校企合作模式，携手培育真正能够代表中国并达到世界顶尖水平的科技成果。
- ③ 华为公司董事、战略研究院院长徐文伟表示，华为公司与清华大学在科研领域有着良好的合作基础，清华大学每年为华为公司输送了大量优秀人才。清华大学等顶尖大学更是基础科学研究的主力军。非常高兴能够与清华大学建立长期深入的战略合作关系，期待双方在基础科学研究、交叉学科研究等方面取得新的更大突破



【北大/清华/复旦/厦大获批国家集成电路产教融合创新平台】

- ① 近日，教育部发文，正式批复同意北京大学、复旦大学、厦门大学、清华大学承担的“国家集成电路产教融合创新平台”项目可研报告，实施期从2019年起至2021年。
- ② 复旦大学：项目建设总经费4.7亿元，实施期从2019年起至2021年。复旦大学国家集成电路产教融合创新平台以该校微电子学院为建设主体，联合国内龙头企业合作共赢，将针对我国集成电路发展中的关键“卡脖子”难题，深入研发新一代节点集成电路共性技术，涵盖芯片设计、EDA工具、器件工艺与芯片封装等方向，着力推进长三角集成电路产业发展。平台重点突出集成电路紧缺人才的培养与工程实践，建成后具备每年为2000人次提供集成电路实训手段的能力。
- ③ 北京大学：北京大学国家集成电路产教融合创新平台项目批复总投资超过3亿元，建设周期3年。将依托北京大学在集成电路器件方向的研究基础，与中芯北方、华大九天、兆易创新、北大方正集团等北京地区集成电路龙头企业合作建设。国家集成电路产教融合创新平台是北京大学微电子学科人才培养、科研创新和学科建设的重要载体。
- ④ 厦门大学：厦门大学国家集成电路产教融合创新平台以厦门大学国家示范性微电子学院为建设主体，联合国内龙头企业，建立合作共赢的融合模式，打造海西地区新型产教融合创新平台。



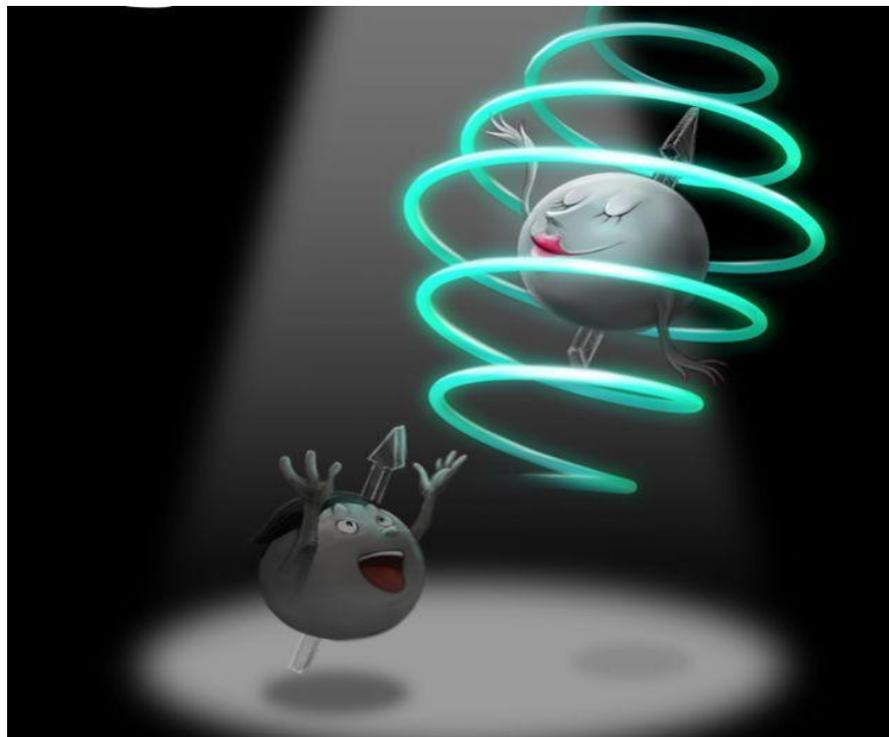
科技前沿

- 点评：
- ① 中科大杜江峰院士研究团队首次在量子世界中观察到宇称时间对称。
 - ② 复旦大学利用近红外技术实现活体信息存储和解码。
 - ③ 王中林院士获爱因斯坦世界科学奖。



【我科学家首次在量子世界观察到宇称时间对称】

SIIP CHINA
SEMI产业创新投资平台



图为杜江峰团队通过量子调控，巧妙加入核自旋辅助比特“小明”

近日，中国科学技术大学杜江峰院士研究团队首次在量子世界中观察到宇称时间对称。该观测方法及其过程突破了传统量子体系中对量子系统的调控方法，加深了量子系统相互作用的理解，有助于人们更好认识微观世界的奇妙性质。研究成果于5月31日在线发表于国际权威期刊《Science》。



【复旦大学利用近红外技术实现活体信息存储和解码】

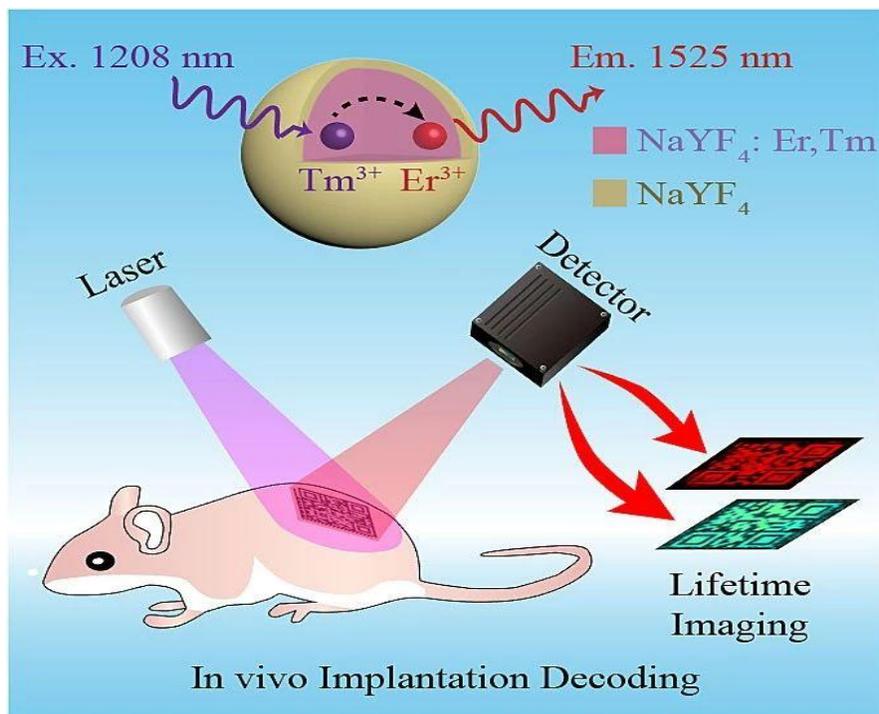


图 Tm^{3+} 敏化 Er^{3+} 发射的稀土纳米颗粒用于活体的多重信息存储和解码

近日，复旦大学化学系张凡课题组报道了系列 Tm^{3+} 敏化的近红外二区激发（1208nm）和二区发射（1525nm）的稀土发光材料。利用该类材料荧光寿命可调节的性质，结合时间门荧光成像技术和相应算法，可以解析活体内具有不同荧光寿命的二维码信息图形。该类材料及方法有望实现高通量的活体信息存储和解码。



【王中林院士获爱因斯坦世界科学奖】

6月14日，2019年度“阿尔伯特·爱因斯坦世界科学奖”揭晓，中国科学院北京纳米能源与系统研究所首席科学家、国科大纳米学院院长、美国佐治亚理工学院终身讲席教授王中林，凭借在微纳能源和自驱动系统领域的开创性成就，斩获这一世界性的大奖，成为首位获此殊荣的华人科学家。

【图灵奖得主、RISC-V 发明人牵头成立清华-伯克利RISC-V国际开源实验室】

6月12日，图灵奖得主、计算机体系结构领域享誉世界的科学家大卫·帕特森在瑞士宣布，将依托清华-伯克利深圳学院（TBSI），建设RISC-V国际开源实验室，又称大卫·帕特森RIOS图灵奖实验室。



人事变迁

- 点评：
- ①上海微系统所领导调整：谢晓明出任法人，王曦荣任科技部副部长。
 - ②蒋尚义将不再连任中芯国际独董。
 - ④三星、IBM、JDI将裁员。



【上海微系统所领导调整：谢晓明出任法人，王曦荣任科技部副部长】

6月14日，上海微系统所举行领导干部调整宣布会。上海分院分党组书记、副院长、沪区党委书记李正华代表院党组宣读了院党组的决定，因王曦同志荣任科技部副部长职务，免去其上海微系统所所长职务，由谢晓明同志出任微系统所法定代表人。

【蒋尚义将不再连任中芯国际独董】

中芯国际在一则有关股东周年大会的通告中宣布，独立非执行董事蒋尚义已通知董事会，基于个人原因和其他工作承诺，将不于股东周年大会上膺选连任独立非执行董事，并将于股东周年大会上退任为董事。

【三星正在远离中国制造，惠州工厂裁员无法估量】

继去年底关闭天津工厂后，三星又被曝出已启动惠州工厂的裁员工作，这也是三星在华最后一家手机工厂。

【外媒：IBM计划裁员1700名】

根据CNBC报道，IBM正在进行小规模裁员工作。接近该裁员事件的人士称，裁员数量为员工总数的0.5%。IBM目前全球有34万员工，这意味着涉及此次裁员的员工数将达到1700名。

【JDI宣布关闭多条产线并裁员1200人】

日媒报道，日本显示公司（JDI）将进行额外重组措施，包括将日本本土裁员人数增加至1200人，同时公司CEO月崎义幸将于9月辞职，现任CFO菊岡稔将接替其职位。



焦点关注

点评：①安集微成功IPO过会，科创板半导体第一股出炉。
②华为就孟晚舟事件再发声：美政府证据不足，加拿大滥用引渡程序。



【安集微成功IPO过会，科创板半导体第一股出炉】

- ① 6月5日，上海证券交易所科创板股票上市委员会召开了2019年第一次审议会议，审议微芯生物、安集微、天准科技三家企业的上市申请。据可靠消息，安集微电子、微芯生物、天准科技三家企业皆成功过会。
- ② 目前，上交所科创板已受理企业达到119家，其中集成电路企业达12家，包括晶晨股份、睿创微纳、乐鑫科技、澜起科技、聚辰股份、晶丰明源、和舰芯片、神工股份、硅产业集团、华特股份、安集科技、中微公司等，安集微电子是科创板过会的第一家半导体厂商。

【华为就孟晚舟事件再发声：美政府证据不足，加拿大滥用引渡程序】

6月7日，华为就孟晚舟事件发表最新声明，表达了几点立场：

- ① 一是美国对孟晚舟的指控在加拿大法律下不构成犯罪。
- ② 二是美国政府提交的证据材料不充分，对孟晚舟的指控不成立。
- ③ 三是加拿大的执法存在严重的程序滥用。四是此案件是受政治和经济因素驱动，而不是出于法律考虑。



专利要闻

点评：①无人驾驶、新型显示技术等领域竞争激烈，龙头企业竞相申请新专利。



类别	公司/单位	事件内容
新专利	苹果	获太阳能电池板专利。
新专利	苹果	新专利：改进汽车门结构。
新专利	苹果	为高机密工作申请了一项AR新专利。
新专利	百度	基于实时交通信息在无人驾驶车辆中提供内容新方式。
新专利	特斯拉	新专利：能有效地降低事故的发生。
新专利	微软	获柔性显示专利，将用于可折叠Windows 10设备。
新专利	OPPO	新专利：折叠屏幕手机采用弹出式摄像头设计。
新专利	OPPO	已为包含滑盖前置相机手机申请专利。
新专利	OPPO	折叠屏手机玩出新花样：弹出式前置双摄像头
新专利	小米	屏下摄像头技术公布。
数据	中国	商务部：中国发明专利申请量连续8年居世界首位。



SIIP CHINA

【SEMI产业创新投资平台-SIIP CHINA】是依托SEMI全球产业资源，汇聚全球产业资本、产业智慧搭建的专业而权威的产业投融资交流平台。SIIP CHINA产业创新投资平台，旨在推进中国半导体产业可持续发展，提供全球技术与投资对接机遇，促进中国与全球合作伙伴的协作，寄期望平台成为大半导体业界最具影响力的产业投资平台。



联系我们

SEMI中国 Lily Feng
Tel: +86-21-60278500
E-MAIL: lifeng@semi.org
<http://www.semi.org.cn/siip>

订阅半导体产业新闻半月刊（精华版）欢迎来信索取
(来信请附名片并注明公司名称、职务、联系电话)
SEMI中国 Lily Feng
E-MAIL: lifeng@semi.org

